

KLEBER GAP PAD Flextein S30S

产品介绍

Flextein S30S是由超柔软的聚合物与高导热填充剂复合而成，在Flextein S30的基础上进一步提高了材料的表面粘性、可压缩性和贴服性。当材料贴合在元器件一面后，经过长距离运输，材料也不会发生脱落、移位。是跨区域电子装配的理想导热界面材料。

Flextein S30S两面具有自然粘性，装配时只需轻轻按压紧，无需背胶即可固定在元器件上。产品的厚度可以在0.3-10.0mm范围内根据客户的需求而定制，也可以选择单面粘性便于使用。

性能及特点

- 导热系数3.0 W/m·K
- 柔软且具有优异的可操作性
- V-0阻燃等级
- 厚度范围 0.012” (0.30mm)至0.40” (10.0mm)



性能参数

| 特性 | 单位 | 参数 | 测试标准 |
|--------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 颜色 | - | 浅蓝色 | 目测 |
| 厚度 | mm | 0.3-10.0 | ASTM D374 |
| 导热系数 | W/m.k | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 热阻 | @1mm,20psi | 0.42°C.in ² /W | ASTM D5470 |
| 硬度 | Shore OO | 35 | ASTM D2240 |
| 比重 | g/cm ³ | 3.0 | ASTM D792 |
| 介电强度 | KV/mm | ≥6.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1.0×10 ¹² | ASTM D257 |
| 介电常数 | @1MHz | 6 | ASTM D150 |
| 连续使用温度 | °C | -40-150 | Kleber |
| 阻燃特性 | - | V-0 | 94 UL |
| RoHS | - | Yes | Kleber |

典型应用

- 电脑和服务器及其周边
- 智能手机、平板多媒体
- 高端网络设备
- 光通讯模块

产品配制

- 标准尺寸470×470 mm，可根据顾客的需求裁切
- 标准厚度：0.3mm(0.012”)至 10mm(0.4”)，以 0.5mm(0.02”)递增。可依客户需求定制厚度。
- 可选择双面粘性、单面粘性，可依需求背胶

储存条件

- 常温密封避光，并放置在干燥的地方储存。
- 最佳储存条件：温度 25°C (±3) ，湿度 50% (±10) ，可保存 12 个月。
- 开封后取出的材料可能在使用的过程中受到污染，不要再将受污染的产品与未开封的产品混合放置。科蓝柏公司不对被污染的产品或要求的储存条件以外的情况承担责任。
- 如需其他信息，请及时联系您对接的销售、技术支持或者客服人员。

声明

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息 (包括产品使用和应用建议) 基于我们对科蓝柏产品的了解和经验。此TDS包含的数据仅供参考，并被认为是可靠的。我们不能对他人因我们无法控制的方法而获得的结果承担责任。该产品在您的环境中可以有各种不同的应用以及不同的工作条件，这是我们无法控制的。因此，科蓝柏公司对产品是否适合您使用它们的生产过程和条件以及预期的应用和结果不承担任何责任。我们强烈建议您在产品使用前事先进行试验以确认产品的适用性。